

# YDIV14-0618SC1

## 6-18GHz功分器 数据手册



四川益丰电子科技有限公司

Sichuan YiFeng Electronic Science & Technology Co., LTD

### 产品简介

YDIV14-0618SC1 型 GaAs 单片集成 0 度功分器，在 6~18GHz 的频率范围具有较低的插损和优良的端口驻波特性，非常适合应用于微波混合集成电路和多芯片模块。

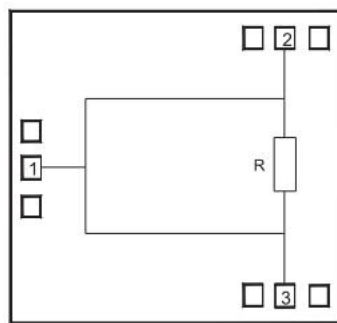
该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

### 关键技术指标

- 工作频段：6 to 18 GHz
- 插入损耗：1.1 dB
- 芯片尺寸：1.4mm x 0.8mm

### 应用领域

- 微波无线电
- 测试测量
- RF/微波电路
- 仪器仪表
- 军事和航天



YDIV14-0618SC1 功能框图



**极限参数**

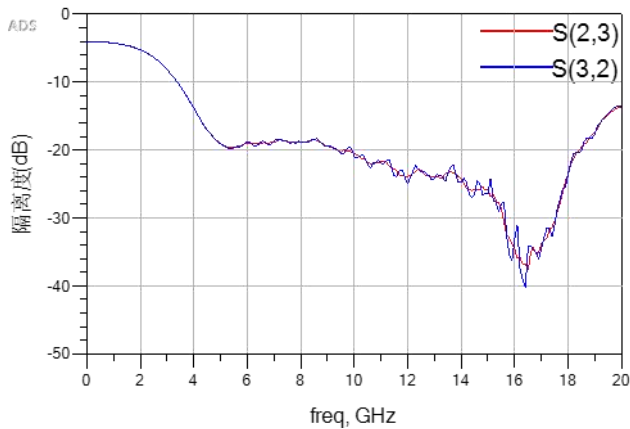
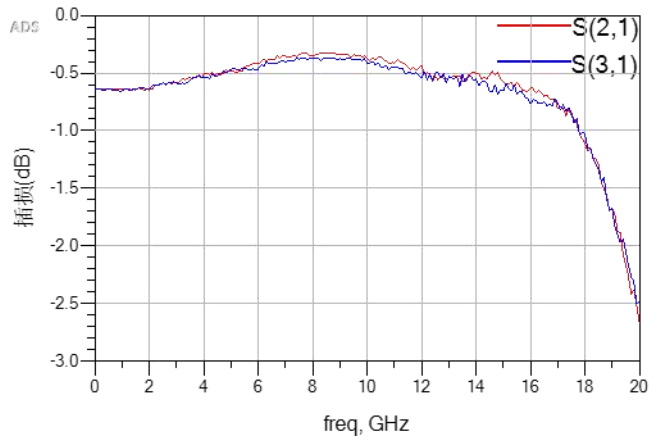
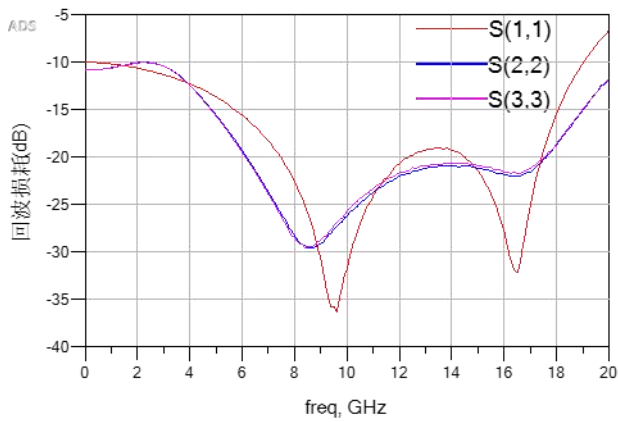
|              |              |
|--------------|--------------|
| 储存温度         | -65 ~ +150°C |
| 工作温度         | -55 ~ +125°C |
| 结温           | 175°C        |
| 静电防护等级 (HBM) | Class1A      |

注意：高功率应用时，请采用共晶烧结工艺安装芯片。

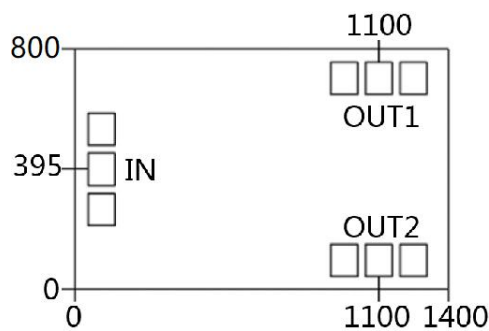
**电性能表 (TA=+25°C, 50 system)**

| 指标    | 最小值   | 典型值  | 最大值 | 单位  |
|-------|-------|------|-----|-----|
| 频率范围  | 6- 18 |      |     | GHz |
| 输入驻波比 | -     | 1.4  | -   | -   |
| 输出驻波比 | -     | 1.26 | -   | -   |
| 插入损耗  | -     | 1.1  | -   | dB  |
| 隔离度   | -     | 18.8 | -   | dB  |

## S 参数曲线



## 外形尺寸



说明:

1. 单位: 微米
2. 芯片背面镀金
3. 芯片背面接地
4. 键合压点镀金, 压点尺寸: 100x100 (um)
5. 不能再通孔上进行键合
6. 外形尺寸公差:  $\pm 0.05\text{mm}$

### 键合压点定义

| 压点编号 | 功能符号       | 功能描述          |
|------|------------|---------------|
| 1    | IN         | RF 输入端口，阻抗 50 |
| 2、3  | OUT1, OUT2 | RF 输出端口，阻抗 50 |
|      | GND        | 芯片背面必须接地      |

### 推荐装配图

